

めっき技術を用いた 導電性フィラーのご紹介

(Cu/Si/Al/Ni コア Agめっきフィラー)

MM Co., Ltd.

MM Confidential

【コア材種類】

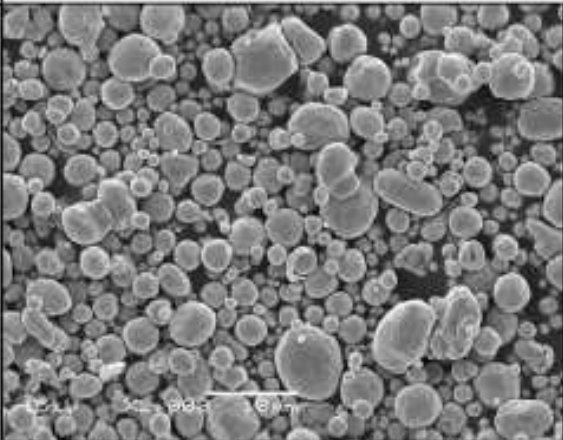
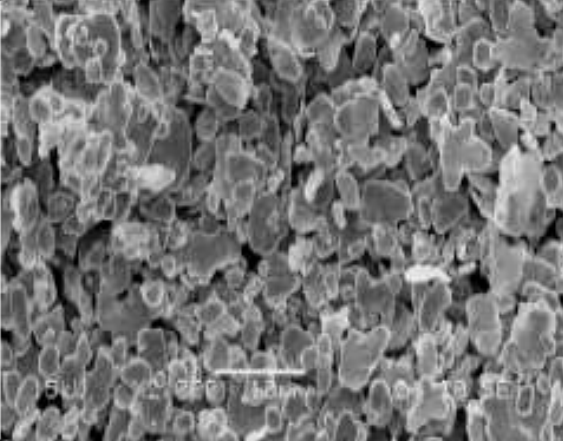
Cu, Al, Si, Ni, etc (用途に応じて使い分けください)

例: $\frac{\text{Cu}}{\downarrow \text{コア材}} \frac{10}{\downarrow \text{代表粒径}(\mu\text{m})} \frac{\text{P}}{\downarrow \text{P: 粒子状}} - \frac{\text{Ag}}{\downarrow \text{めっき種}} \frac{10}{\downarrow \text{めっき量}(\text{wt}\%)}$

F: フレーク状

銅コア銀めっきフィラー



品名	粒度(μm) $D_{10} / D_{50} / D_{90}$	かさ密度 (g/cm^3)	銀コート量 (%)	SEM観察図
Cu5P-Ag10 (粒子タイプ)	3 / 6 / 9	3.7	10	
Cu5F-Ag20 (フレークタイプ)	3 / 5 / 10	2.0	20	

※上記データは規格値では御座いません。 MM Confidential

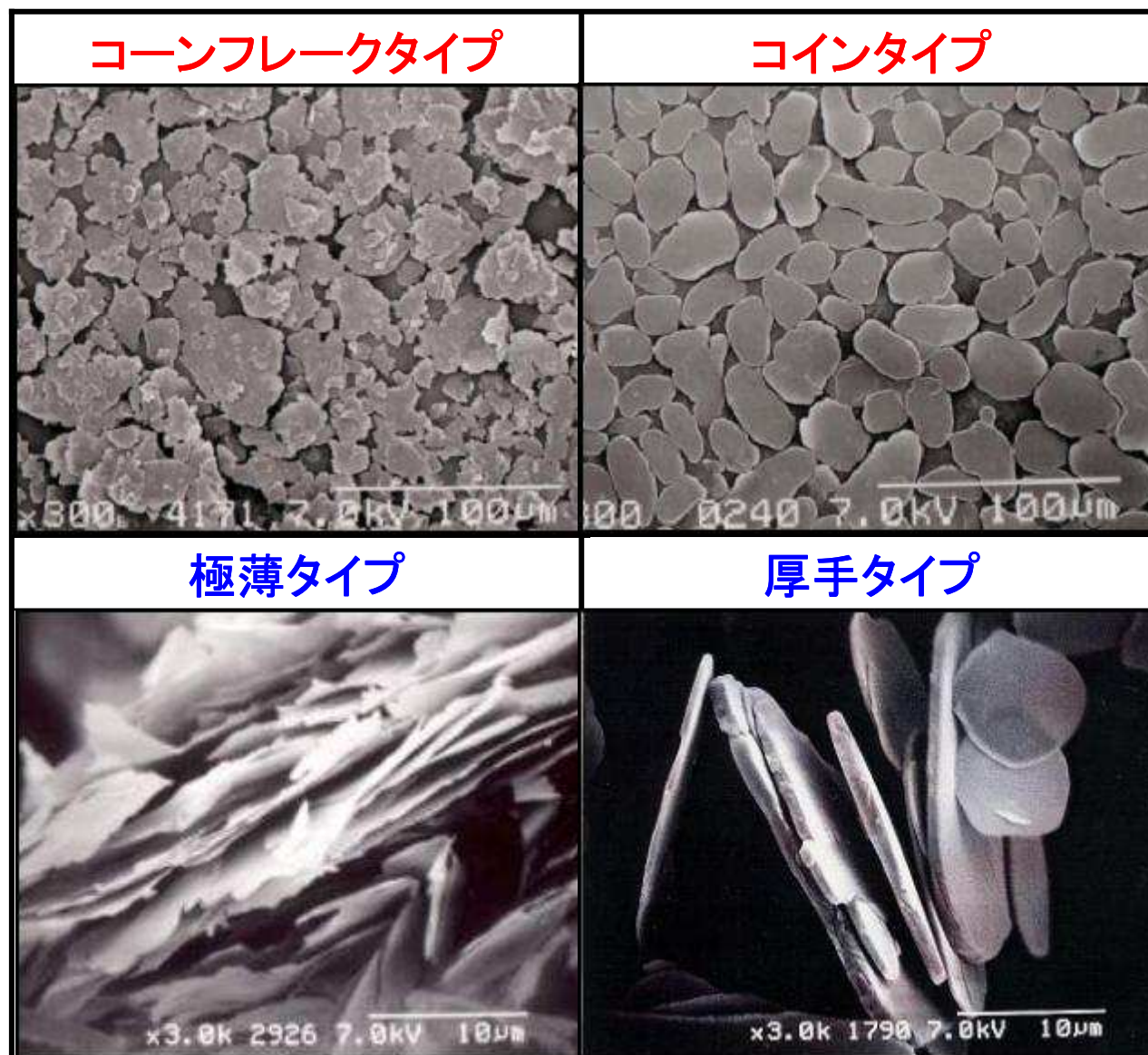
低比重品コア銀めっきフィラー



品名	粒度(μm) $D_{10} / D_{50} / D_{90}$	かさ密度 (g/cm^3)	銀コート量 (%)	SEM観察図
$\text{SiO}_2\text{5P-Ag30}$	3 / 6 / 11	0.5	30	
Al5P-Ag30	5 / 7 / 10	1.2	30	
Al30P-Ag10	20 / 30 / 45	1.4	10	

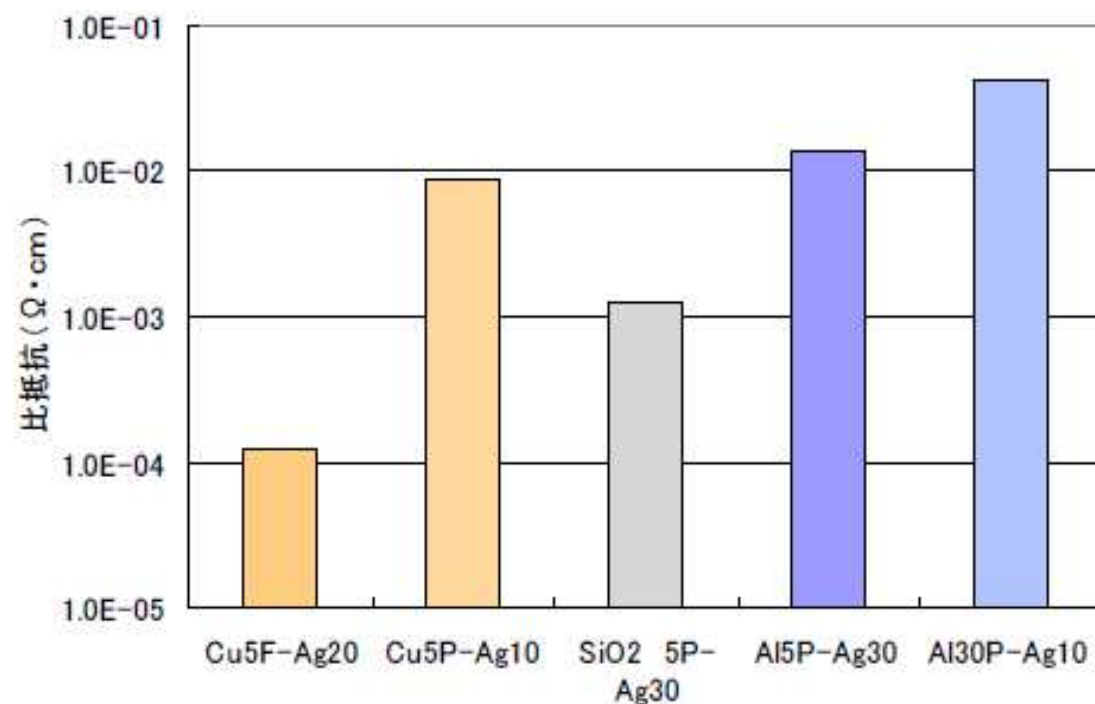
※上記データは規格値では御座いません。 **MM Confidential**

フレーク形状の制御例



フレークの厚み、形状を変化させる事で、インキ粘度やフィラー同士の接点機会をコントロールできる。

各フィラーの社内評価結果



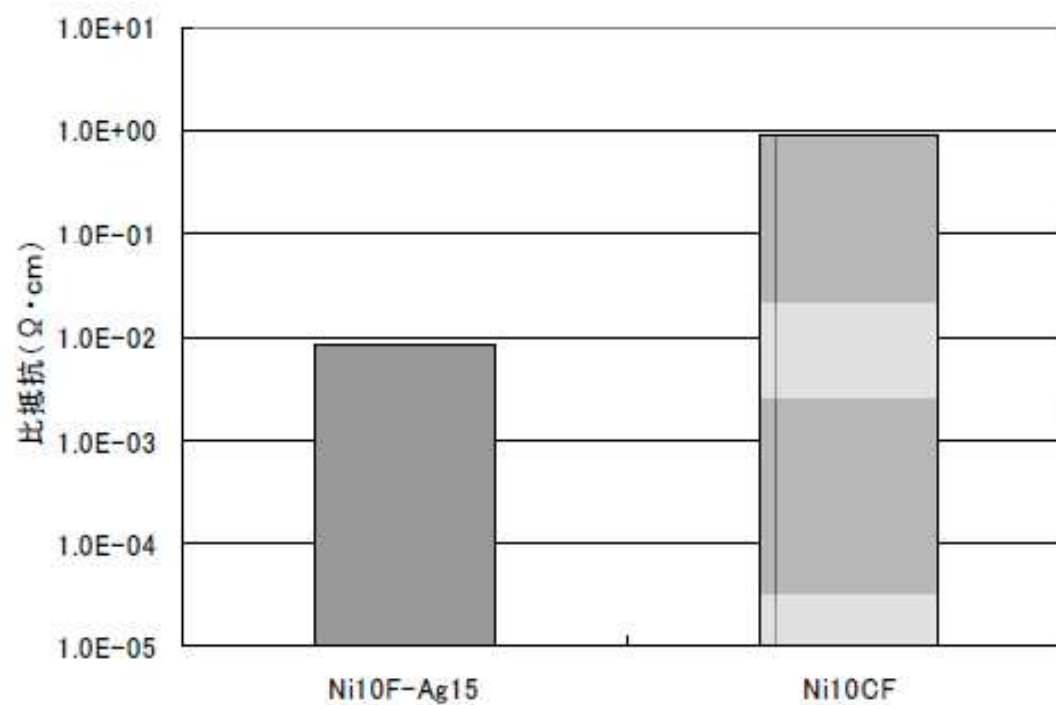
試験条件

フィラー濃度: 60vol% (※)

バインダー: アクリル系樹脂

(※) Al5P-Ag30のみ70vol%

各フィラーの社内評価結果(2)



試験条件

フィラー濃度: 60vol% (※)

バインダー: アクリル系樹脂

更に詳しい資料の必要な方は
ご連絡をいただければ対応いたし
ます。